

技术数据表 Technical Data Sheet **DYG100-1D**

版本号: V01

1. 典型性能指标

测试项目	単位	典型值
环保或非环保		环保
外观		黑色
树脂类型		EOCN/DCPD+PN
填料类型		角形
填料含量	%	83
填料最大尺寸	um	180
阻燃 UL-94@1/8"		V-0
胶化时间	S	35
流动长度	inch	25
玻璃化转变温度 Tg	${\mathbb C}$	177
热膨胀系数 1	ppm	19
热膨胀系数 2	ppm	59
弯曲强度@25℃	Мра	116
弯曲模量@25℃	Мра	17312
吸水率(PCT24h)	%	0.36
比重	g/cm3	2.18
导热系数	W/m.K	1.88
成型收缩率	%	0.35
体积电阻率@25℃	$ imes 10^{15} \Omega.cm$	5
电导率	μs/cm	45
рН		6.1
氯离子含量	ppm	54
钠离子含量	ppm	7

2. 成型及后固化条件

封装模具类型		传统模/自动模
模塑温度	°C	170-190
模塑固化时间	sec	90-150
后固化温度	$^{\circ}$ C	175
后固化时间	h	4-8

3. 运输储存条件/有效期

= 1m · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
运输储存条件	5℃以下	
有效期	6 个月	

备注:以上数据基于上海道宜半导体材料有限公司实验室测试结果,非保证值,典型值仅供参考。

上海道宜半导体材料有限公司 DOITECH Semiconductor Advanced Material Co., Ltd中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正琅路 19 号 4 幢